

海通证券股份有限公司关于杭州晶华微电子股份有限公司

2023 年持续督导半年度跟踪报告

保荐机构名称：海通证券股份有限公司	被保荐公司简称：晶华微
保荐代表人姓名：薛阳、余冬	被保荐公司代码：688130

重大事项提示

2023 年 1-6 月，晶华微营业收入 6,493.21 万元，较上年同期下降 5.02%；归属于上市公司股东的净利润为 221.88 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-315.49 万元，分别较去年同期下降 91.53%、114.81%，下滑幅度较大。公司预计未来在技术研发、人员费用方面仍需保持较大的投入。如果半导体行业仍处于下行周期，消费景气度缓慢复苏，业务拓展及研发项目进展不及预期，预计公司未来仍可能出现业绩下滑或亏损的情形。提醒广大投资者对公司的业绩波动、由盈转亏的情况予以关注。

经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州晶华微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1203 号）批复，杭州晶华微股份有限公司首次公开发行股票 1,664 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 62.98 元，募集资金总额为人民币 104,798.72 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 92,053.70 万元。本次发行证券已于 2022 年 7 月 29 日在上海证券交易所上市。海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“海通证券”）担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2022 年 7 月 29 日至 2025 年 12 月 31 日。

在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日持续督导期内（以下简称“本持续督导期间”），保荐机构及保荐代表人按照《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“保荐办法”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式进行持续督导，现就 2023 年半年度持续督导情况报告如下：

一、2023年1-6月保荐机构持续督导工作情况

项目	工作内容
1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。	保荐机构已建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。
2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。持续督导期间，协议相关方对协议内容做出修改的，应于修改后五个交易日内报上海证券交易所备案。终止协议的，协议相关方应自终止之日起五个交易日内向上海证券交易所报告，并说明原因。	保荐机构已与上市公司签署了保荐协议，协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务，并已报上海证券交易所备案。本持续督导期间，未发生对协议内容做出修改或终止协议的情况。
3、持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经审核后予以披露。	本持续督导期间，上市公司未发生需公开发表声明的违法违规事项。
4、持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个交易日内向上海证券交易所报告。	本持续督导期间，上市公司及相关当事人未出现需报告的违法违规、违背承诺等事项。
5、通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作。	本持续督导期间，保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访、现场检查、尽职调查等方式，对上市公司开展持续督导工作。
6、督促上市公司建立和执行规范运作、承诺履行、分红回报等制度。	保荐机构已督促上市公司建立和执行规范运作、承诺履行、分红回报等制度。
7、督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺。	保荐机构持续督促、指导上市公司及其董事、监事、高级管理人员，遵守相关法律法规的要求，并切实履行其所做出的各项承诺。
8、督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。	核查了上市公司治理制度建立与执行情况，上市公司《公司章程》、三会议事规则等制度符合相关法规要求，本持续督导期间，上市公司有效执行了相关治理制度。
9、督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。	持续督导机构持续督导晶华微建立健全并有效执行内控制度，并就部分内部控制有待完善的事项通过日常沟通、定期或不定期回访等方式持续督促其进行整改。
10、督导上市公司建立健全并有效执行信息	保荐机构督促上市公司严格执行信息披露制

项 目	工作内容
披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。	度，审阅信息披露文件及其他相关文件，详见“二、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况”。
11、对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。	详见“二、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况”。
12、对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。	详见“二、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况”。
13、关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所监管措施或纪律处分的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正。	<p>1、2023年4月28日，晶华微发布《关于前期会计差错更正及定期报告更正的公告》，对于公司工控仪表类芯片产品的部分业务，基于实质重于形式判断，公司身份并非主要责任人，应对涉及的交易收入确认方法由“总额法”更正为“净额法”，需对2022年半年度报告及第三季度报告中的相关财务信息进行更正，并同步发布了更正后的定期报告。</p> <p>2023年6月5日，晶华微收到上海证券交易所出具的《关于对杭州晶华微电子股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定书》（上证科创公监函〔2023〕0026号）（以下简称“监管警示函”），因公司前期部分会计处理存在差错，部分业务涉及的交易收入确认方法由“总额法”更正为“净额法”，导致2022年半年度及第三季度报告相关财务信息披露不准确，对晶华微及时任财务总监周荣新、时任董事长兼代行财务总监吕汉泉予以监管警示。</p> <p>2、2023年8月30日，晶华微发布《关于前期会计差错更正及定期报告更正的公告》，由于公司2022年期后退货涉及的收入确认于2022年半年度，经公司自查，上述销售发生时不符合收入确认条件，应调减2022年半年度确认的收入，公司需对2022年半年度报告、2022年第三季度报告中的相关财务信息进行</p>

项目	工作内容
	<p>更正，并同步公告了更正后的定期报告；同日，晶华微收到上海证券交易所出具的《关于对杭州晶华微电子股份有限公司会计差错更正事项的监管工作函》（上证科创公函（2023）0292号），对公司上述事项进行监管关注。</p> <p>针对上述事项，公司及相关责任人高度重视监管警示函中提出的问题，认真吸取教训，切实加强了对《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的学习，加强财务会计基础工作，强化信息披露管理，维护公司及全体股东的合法权益，促进公司健康、稳定、持续发展。</p> <p>保荐机构和保荐代表人已督促公司及相关人员按照监管部门的要求积极整改，加强对上市公司法律法规和规范性文件的学习，加强财务会计基础工作，不断提高公司信息披露质量，促进公司健康、稳定和持续发展，更好地维护和保障投资者权益。</p>
<p>14、关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，应及时向上海证券交易所报告。</p> <p>上市公司或其控股股东、实际控制人作出承诺的，保荐机构、保荐代表人应当督促其对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、履约风险及对策、不能履约时的救济措施等方面进行充分信息披露。</p> <p>保荐机构、保荐代表人应当针对前款规定的承诺披露事项，持续跟进相关主体履行承诺的进展情况，督促相关主体及时、充分履行承诺。</p> <p>上市公司或其控股股东、实际控制人披露、履行或者变更承诺事项，不符合法律法规、上市规则以及上海证券交易所其他规定的，保荐机构和保荐代表人应当及时提出督导意见，并督促相关主体进行补正。</p>	<p>本持续督导期间，上市公司及控股股东、实际控制人等不存在未履行承诺的情况。</p> <p>上市公司或其控股股东、实际控制人已对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、履约风险及对策、不能履约时的救济措施等方面进行充分信息披露。</p>
<p>15、关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，应及时督促上市公司</p>	<p>本持续督导期间，上市公司未出现该等事项。</p>

项 目	工作内容
<p>如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告。</p>	
<p>16、发现以下情形之一的，应督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：</p> <p>（一）上市公司涉嫌违反《上市规则》等上海证券交易所相关业务规则；</p> <p>（二）中介机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；</p> <p>（三）上市公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；</p> <p>（四）上市公司不配合保荐机构持续督导工作；</p> <p>（五）上海证券交易所或保荐机构认为需要报告的其他情形。</p>	<p>2023年6月5日，晶华微收到上海证券交易所出具的《关于对杭州晶华微电子股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定书》（上证科创公监函〔2023〕0026号）（以下简称“监管警示函”），因公司前期部分会计处理存在差错，部分业务涉及的交易收入确认方法由“总额法”更正为“净额法”，导致2022年半年度及第三季度报告相关财务信息披露不准确，违反了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》第五条、第十六条，《上海证券交易所科创板股票上市规则》第1.4条、5.1.2条等有关规定，对公司及时任财务总监周荣新、时任董事长兼代行财务总监吕汉泉予以监管警示。</p> <p>保荐机构和保荐代表人已督促公司及相关人员按照监管部门的要求积极整改，加强对上市公司法律法规和规范性文件的学习，加强财务会计基础工作，不断提高公司信息披露质量，促进公司健康、稳定和持续发展，更好地维护和保障投资者权益。</p>
<p>17、制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查质量。保荐机构对上市公司的定期现场检查每年不应少于一次，负责该项目的两名保荐代表人至少应有一人参加现场检查。</p>	<p>保荐机构制定了对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求。</p>
<p>18、重点关注上市公司是否存在如下事项：</p> <p>（一）存在重大财务造假嫌疑；</p> <p>（二）控股股东、实际控制人及其关联人涉嫌资金占用；</p> <p>（三）可能存在违规担保；</p> <p>（四）控股股东、实际控制人及其关联人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；</p> <p>（五）资金往来或者现金流存在重大异常；</p> <p>（六）本所或者保荐人认为应当进行现场核查的其他事项。</p> <p>出现上述情形的，保荐机构及其保荐代表人应当督促公司核实并披露，同时应当自知道或者应当知道之日起15日内按规定进行专项现场核查。公司未及时披露的，保荐机构应当</p>	<p>本持续督导期间，上市公司及相关主体未出现该等事项。</p>

项 目	工作内容
及时向上海证券交易所报告。	
19、识别并督促上市公司披露对公司持续经营能力、核心竞争力或者控制权稳定有重大不利影响的风险或者负面事项，并发表意见	本持续督导期间，上市公司及相关主体未出现该等事项。
20、关注上市公司股票交易异常波动情况，督促上市公司按照本规则规定履行核查、信息披露等义务	本持续督导期间，上市公司及相关主体未出现该等事项。
21、对上市公司存在的可能严重影响公司或者投资者合法权益的事项开展专项核查，并出具现场核查报告	本持续督导期间，上市公司及相关主体未出现该等事项。
<p>22、上市公司日常经营出现下列情形的，保荐机构、保荐代表人应当就相关事项对公司经营的影响以及是否存在其他未披露重大风险发表意见并披露：</p> <p>（一）主要业务停滞或出现可能导致主要业务停滞的重大风险事件；</p> <p>（二）资产被查封、扣押或冻结；</p> <p>（三）未能清偿到期债务；</p> <p>（四）实际控制人、董事长、总经理、财务负责人或核心技术人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施；</p> <p>（五）涉及关联交易、为他人提供担保等重大事项；</p> <p>（六）本所或者保荐机构认为应当发表意见的其他情形。</p>	本持续督导期间，上市公司及相关主体未出现该等事项。
<p>23、上市公司业务和技术出现下列情形的，保荐机构、保荐代表人应当就相关事项对公司核心竞争力和日常经营的影响，以及是否存在其他未披露重大风险发表意见并披露：</p> <p>（一）主要原材料供应或者产品销售出现重大不利变化；</p> <p>（二）核心技术人员离职；</p> <p>（三）核心知识产权、特许经营权或者核心技术许可丧失、不能续期或者出现重大纠纷；</p> <p>（四）主要产品研发失败；</p> <p>（五）核心竞争力丧失竞争优势或者市场出现具有明显优势的竞争者；</p> <p>（六）本所或者保荐机构认为应当发表意见的其他情形。</p>	本持续督导期间，上市公司及相关主体未出现该等事项。

项 目	工作内容
24、持续关注上市公司建立募集资金专户存储制度与执行情况、募集资金使用情况、投资项目的实施等承诺事项，对募集资金存放与使用情况进行现场检查。	保荐机构对上市公司募集资金的专户存储、募集资金的使用以及投资项目的实施等承诺事项进行了持续关注，督导公司执行募集资金专户存储制度及募集资金监管协议。
25、上市公司及其控股股东、董事、监事、高级管理人员是否存在未依法规范运作，未切实保障投资者的合法权益，侵害投资者利益的情况	本持续督导期间，上市公司及相关主体未出现该等事项。
26、保荐机构发表核查意见情况。	<p>本持续督导期间，保荐机构发表核查意见具体情况如下：</p> <p>2023年1月13日，保荐机构发表《海通证券股份有限公司关于杭州晶华微电子股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》；</p> <p>2023年4月26日，保荐机构发表《海通证券股份有限公司关于杭州晶华微电子股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见》与《海通证券股份有限公司关于杭州晶华微电子股份有限公司追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见》；</p> <p>2023年5月26日，保荐机构发表《海通证券股份有限公司关于杭州晶华微电子股份有限公司2022年年度报告的信息披露监管问询函的专项核查意见》。</p>
27、保荐机构发现的问题及整改情况（如有）	<p>1、2023年1-6月，公司营业收入6,493.21万元，较上年同期下降5.02%；归属于上市公司股东的净利润为221.88万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-315.49万元，分别较去年同期下降91.53%、114.81%，下降幅度较大。2023年1-6月，公司经营业绩同比下降，主要原因如下：①受半导体行业仍处于下行周期，消费景气度缓慢复苏等因素影响，公司营业收入同比下降，主营业务毛利率有所下滑；②为保持市场竞争力，公司技术研发、人员费用投入较大；③由于半导体市场下行以及公司备货较多，导致当期计提资产减值损失增加；综上，公司业绩下滑主要由于行业周期性波动、研发投入较大、资产减值损失增加等因素导致，具有合理性。保荐机构提请公司做好相关信息披露工</p>

项 目	工作内容
	<p>作，及时、充分地揭示相关风险，切实保护投资者利益。</p> <p>2、2023年6月5日，晶华微收到上海证券交易所出具的《关于对杭州晶华微电子股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定书》（上证科创公监函〔2023〕0026号），因公司前期部分会计处理存在差错，部分业务涉及的交易收入确认方法由“总额法”更正为“净额法”，导致2022年半年度及第三季度报告相关财务信息披露不准确，对晶华微及时任财务总监周荣新、时任董事长兼代行财务总监吕汉泉予以监管警示。</p> <p>持续督导机构也将持续跟踪并督导公司整改情况，督促上市公司建立健全、遵守并执行内控制度，加强财务会计基础工作，完善公司治理，及时履行信息披露和风险提示义务，并将及时就持续督导了解的最新情况向浙江证监局和上海证券交易所报告。</p>

二、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况

海通证券持续督导人员对上市公司本持续督导期间的信息披露文件进行了事先或事后审阅，包括股东大会会议决议及公告、董事会会议决议及公告、监事会会议决议及公告、募集资金使用和管理的相关报告和其他临时公告等文件，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。

经核查，保荐机构认为，在本持续督导期间上市公司严格按照证券监督部门的相关规定进行信息披露，依法公开对外发布各类定期报告或临时报告，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、重大风险事项

公司面临的风险因素主要如下：

（一）公司未来业绩存在可能无法持续增长或下滑的风险

2020年公司业绩大幅增长，实现主营业务收入19,729.21万元，主要系新冠影响拉动的产品需求，具有偶发性；2021年，随着新冠影响逐步得到控制，红外

测温信号处理芯片终端爆发性需求回落，公司红外测温信号处理芯片销售收入从 2020 年的 12,764.97 万元下降至 3,016.05 万元，同比收入下降。2022 年，受下半年宏观经济与行业下行影响，公司实现营业收入 11,104.33 万元，较上年同期下降 35.97%。2023 年 1-6 月，由于半导体行业仍处于下行周期，消费景气度缓慢复苏，公司营业收入为 6,493.21 万元，较去年同期下降 5.02%。

若未来公司医疗健康 SoC 芯片、工业控制及仪表芯片和智能感知 SoC 芯片等下游需求下降、上游成本费用上升，或主要客户出现变动，进而导致产品的销量或毛利率下降，可能对公司的销售收入和经营业绩产生不利影响，公司业绩存在可能无法持续增长或下滑的风险。

（二）核心竞争力风险

1、新产品开发的风险

集成电路设计行业属于技术密集型行业，产品升级换代及技术迭代速度较快，持续的研发投入、技术升级及新产品开发是保持竞争优势的重要手段。公司主要从事高性能模拟及数模混合集成电路的研发，主要产品包括医疗健康 SoC 芯片、工业控制及仪表芯片、智能感知 SoC 芯片等，由于模拟类技术原理和系统框架相对稳定，核心技术迭代周期相对较长，而在具体产品层面，与数字芯片相比，公司产品生命周期较长，往往一颗芯片推出后可以在市场上活跃 5-10 年时间，距今时间较近的产品一般为前代产品的升级版，其技术指标更加优化。随着医疗健康、工控仪表、可穿戴设备、物联网等领域智能化趋势的发展，对公司的产品研发能力提出了更高的要求，公司必须根据不同类别芯片的市场需求变动和技术水平发展对现有技术进行升级迭代，以保持技术和产品的竞争力。

未来，如果公司无法持续提升研发能力、无法根据终端市场需求不断开发、引进新的产品系列、无法在高端应用产品领域实现技术突破，则可能使公司在日益激烈的市场竞争环境中处于劣势地位，从而会对公司市场份额和核心竞争力产生不利影响。

2、技术和产品被替代的风险

公司主营业务的 SoC 芯片系基于 Sigma-Delta 电路结构为基础的高精度 ADC 技术，针对下游具体领域的应用需求，研究和创新电路细节，在特定工艺及成本的条件下实现高精度、低噪声、低功耗、高集成度等性能，并完善其他相关高性能模拟信号链电路资源设计、辅以内置算法，推出了医疗健康 SoC 芯片、工业控制及仪表芯片、智能感知 SoC 芯片等系列产品。

从目前的技术路径来看，相比于“模拟分立运放+ADC+通用 MCU”的多芯片组合方案，SoC 单芯片在集成度、稳定性、量产成本、使用灵活性等方面更加出色。但多芯片组合方案在某些特定应用范围上可能具有一定优势，如在超高端数字万用表领域，由于其功能程序要求十分复杂，导致部分型号很难采用 SoC 单芯片解决方案实现兼容或替代，需配置性能更好的模拟前端类芯片与具备不同数字资源的通用型 MCU 芯片组合。随着半导体技术的不断发展，未来若多芯片组合在产品可靠性、生产成本等方面取得突破性进展，或其他拥有高精度 ADC 技术的公司更多地进入公司目前聚焦的应用领域，则将对公司所在的市场需求造成不利影响，进而影响公司业绩。

（三）经营风险

1、公司业务规模相对较小，业务相对集中的风险

公司专注于高性能模拟及数模混合集成电路的研发与销售，主要产品包括红外测温信号处理芯片、智能健康衡器 SoC 芯片以及工业控制及仪表芯片等，同行业竞争对手芯海科技、圣邦股份、思瑞浦、盛群、松翰科技等其他已上市模拟信号链公司的产品结构还包括语音控制芯片、家用电器类芯片、汽车电子芯片、电源管理芯片等其他种类。与其他已上市模拟信号链芯片公司相比，公司业务范围相对集中，主营业务规模较小，产品线不够丰富，与上述公司相比还有较大差距。如果公司未来不能继续扩大经营规模，丰富产品结构，新产品推出不及时或者毛利率出现下滑，将会对公司的盈利能力带来重大不利影响。

2、公司产品结构相对单一的风险

公司目前收入和利润主要来源于医疗健康 SoC 芯片和工业控制及仪表芯片的研发和销售，公司产品结构相对较为单一，这两类产品在营业收入中的占比超过 95%。由于新产品研究开发、市场推广的整体周期相对较长，如果未来公司现

有产品的市场需求发生较大波动或公司无法及时响应市场对新技术、新功能的需求，新产品无法顺利推出，则将对公司经营带来不利影响。

3、市场竞争风险

集成电路设计行业公司众多，市场竞争逐步加剧。公司主要从事高性能模拟及数模混合集成电路的研发与销售，该等芯片市场的快速发展以及技术和产业链的成熟，吸引了越来越多芯片厂商进入并研发相关产品。目前公司的主要竞争对手中，有国际上的集成电路巨头亚德诺、德州仪器、意法半导体及美信等，也有中国境内的芯海科技以及中国台湾地区的松翰科技、盛群、富晶半导体及纮康科技等，与上述行业内国际大型厂商相比，公司在整体资产规模、资金实力等方面仍然存在一定的差距。国内方面，随着本土竞争对手日渐加入市场，竞争对手的低价竞争策略可能导致市场价格下降、行业利润缩减等状况。若公司不能正确把握市场动态和行业发展趋势，不能根据客户需求及时进行技术和产品创新，则公司的行业地位、市场份额、经营业绩等可能受到不利影响。

4、供应商较为集中的风险

公司采用 Fabless 经营模式，主要从事芯片的研发与设计，而将晶圆制造和封装测试等生产环节交由专业的晶圆制造和封装测试厂商完成，采购集中度相对较高。

由于晶圆制造和封装测试行业均属于资本及技术密集型产业，投资规模较大，门槛较高，因此行业集中度较高，具有行业普遍性。如果公司的供应商发生不可抗力的突发事件，或因集成电路市场需求旺盛出现产能紧张等因素，晶圆代工和封装测试产能可能无法满足公司采购需求，将对公司的生产经营产生较大的不利影响。

（四）财务风险

1、毛利率下滑风险

公司综合毛利率水平较高，主要受产品结构、市场需求、销售价格等多种因素影响。未来，如果公司医疗健康 SoC 芯片中的其他系列芯片、工业控制及仪表芯片、智能感知 SoC 芯片等其他芯片未能实现大量出货，或者销售结构发生变

化,公司未能契合市场需求率先推出新产品,或新产品未能如预期实现大量销售,将导致公司综合毛利率出现下降的风险。

2、存货跌价风险

公司存货主要由原材料、在产品、委托加工物资和库存商品构成。随着公司业务规模的不断扩大,存货金额随之上升,公司于资产负债表日根据存货的成本高于可变现净值的金额计提相应的跌价准备。集成电路产品技术更新换代速度较快,若未来市场需求环境发生变化、市场竞争加剧或公司不能有效拓宽销售渠道、优化库存管理、合理控制存货规模,可能导致产品滞销、存货积压的情形,从而使得存货跌价风险提高,将对公司经营业绩产生不利影响。

3、应收账款坏账风险

2023年6月末,公司具有一定规模的应收账款余额。公司已根据谨慎性原则对应收账款计提坏账准备,但随着公司经营规模的持续扩大、或者受市场环境和客户经营情况变动等因素影响放宽信用政策,公司应收账款余额可能逐步增加。若未来公司应收账款不能及时回收,将对公司资金使用效率和经营业绩造成不利影响。

4、税收优惠政策风险

公司于2023年2月收到由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR202233010603),发证日期为2022年12月24日,有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家对高新技术企业的相关税收政策规定,公司自通过高新技术企业重新认定起连续三年(即2022年至2024年)可继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策,按15%的税率缴纳企业所得税。

若未来上述税收优惠政策发生调整,或者公司不再满足享受以上税收优惠政策的条件,则公司可能面临因税收优惠变动或减少,从而降低未来盈利的风险。

(五) 内控风险

1. 实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人为吕汉泉与罗洛仪夫妇。公司首次公开发行股票完成后，吕汉泉直接持有公司 43.27%的股份，通过景宁晶股华间接控制公司 6.82%的股份，罗洛仪直接持有公司 10.76%的股份；同时，罗伟绍与罗洛仪系兄妹关系，为实际控制人的一致行动人，其直接持有公司 6.76%的股份。因此，吕汉泉、罗洛仪夫妇及其一致行动人合计控制公司 67.61%的股份，处于绝对控制地位。如果实际控制人利用其自身控制地位通过股东大会行使表决权，对公司的重大经营决策、董事选举、股利分配政策制定、公司章程修改、对外投资等重大事项进行不当控制，将可能对公司及其他股东特别是中小股东的利益产生不利影响。

2. 管理能力不能满足业务发展需求的风险

近年来公司的业务规模快速增长，随着公司业务不断发展以及募集资金投资项目的实施，公司收入规模、资产规模、研发人员数量持续扩张，相应将在资源整合、市场开拓、产品研发、质量管理、内部控制等方面对管理人员提出了更高要求。如果公司的管理体系和管理制度未能随着公司规模扩张及时调整完善，将使公司一定程度上面临规模扩张导致的管理风险

（六）行业风险

公司是集成电路设计企业，主要从事集成电路芯片产品的设计、研发及销售，属于集成电路行业的上游环节。全球集成电路行业在近些年来一直保持稳步增长的趋势，但由于该行业是资本及技术密集型行业，随着技术的更迭，行业本身呈现周期性波动的特点，并且行业周期的波动与经济周期关系紧密。如果宏观经济发生剧烈波动或存在下行趋势，将导致行业发生波动或需求减少，使包括公司在内的集成电路企业面临一定的行业波动风险，对经营情况造成一定的不利影响。

（七）宏观环境风险

公司终端客户的产品存在销往除中国大陆以外的其他国家和地区的情况，受近年来地缘政治形势及国际贸易环境日趋复杂的影响，如果未来相关国家及地区出于贸易保护等原因，通过贸易政策构建贸易壁垒，限制公司终端客户业务开展，将对公司终端客户产生负面影响，进而对公司的经营业绩造成一定影响。

四、重大违规事项

在本持续督导期间，公司不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

本持续督导期间，公司主要会计数据情况如下：

单位：元

主要会计数据	本报告期 (2023年1-6月)	上年同期(更正后) (2022年1-6月)	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	64,932,104.88	68,362,019.34	-5.02
归属于上市公司股东的净利润	2,218,788.96	26,180,968.11	-91.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,154,924.02	21,304,121.72	-114.81
经营活动产生的现金流量净额	-3,335,335.45	-8,696,260.89	不适用
主要会计数据	本报告期末 (2023年6月末)	上年度末 (2022年12月末)	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,305,387,733.90	1,310,290,477.98	-0.37
总资产	1,323,373,354.71	1,346,539,258.96	-1.72

本持续督导期间，公司主要财务指标情况如下：

主要财务指标	本报告期 (2023年1-6月)	上年同期(更正后) (2022年1-6月)	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.03	0.52	-94.23
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.52	-94.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.05	0.43	-111.63
加权平均净资产收益率(%)	0.17	6.94	减少6.77个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.24	5.65	减少5.89个百分点

研发投入占营业收入的比例 (%)	50.61	24.06	增加 26.55 个百分点
------------------	-------	-------	---------------

1、2023 年 1-6 月，公司营业收入同比下降 5.02%，主要系半导体行业仍处于下行周期，消费景气度缓慢复苏，市场内卷严重所致；公司积极开展业务拓展，单季度营业收入持续改善，2023 年二季度营业收入较一季度环比增长 21.73%。

2、2023 年 1-6 月，公司归属于上市公司股东的净利润为 221.88 万元，同比下降 91.53%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏损 315.49 万元，同比下降 114.81%。主要原因系：

(1) 受半导体行业仍处于下行周期，消费景气度缓慢复苏及市场内卷严重等因素影响，公司营业收入同比下降；且行业下行周期内受供需关系变化的影响，主营业务毛利率为 64.14%，较上年同期有所下降。

(2) 在行业下行周期，公司更加注重在人才积累、技术创新、客户开拓等资源投入，报告期内公司销售费用、管理费用、研发费用同比增长，尤其是公司持续注重研发投入，研发费用同比大幅增加。报告期内，公司研发费用 3,286.48 万元，同比增长 99.85%；研发投入占营业收入的比例为 50.61%，同比增加 26.55 个百分点。主要系：一是公司持续重视研发投入，积极扩充研发团队，至报告期末公司研发人员 124 人，同比增长 65.33%；二是公司推进研发进度，加快产品布局，研发用材料费用同比增长 360.35%。

(3) 受 2021 年产业供应链中下游厂商备货较多，叠加 2022 年下半年以来的宏观经济和半导体下行周期因素影响，报告期内计提资产减值损失 663.59 万元，综合导致公司净利润下降。

3、2023 年 1-6 月，公司经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要系报告期内支付外购物料货款及公司税费大幅减少所致。

4、2023 年 1-6 月，公司基本每股收益、稀释每股收益及扣除非经常性损益后的基本每股收益分别较上年同期下降 94.23%、94.23%和 111.63%，主要系受当期净利润下降，及发行新股使得发行在外的普通股加权平均数变大所致。

5、2023年1-6月，公司股份支付费用为286.25万元，剔除股份支付费用影响后，本期归属于上市公司股东的净利润为508.13万元，同比下降82.12%。

六、核心竞争力的变化情况

本持续督导期间，公司在自主创新能力和技术优势、团队及人才优势、产品差异化竞争优势、整体技术解决方案及本土化服务优势等核心竞争力方面持续强化，具体如下：

（一）自主创新能力和技术优势

公司成立以来，始终坚持自主创新，在低功耗、低误码率的工控仪表芯片领域取得了深厚的技术积累。2008年在国内率先推出工控HART调制解调器芯片，最大调制和解调电流分别低至202uA和258uA，通讯误码率小于百万分之一；2013年，推出国内首款自主研发的工控16位4~20mA电流环DAC芯片，其最大调制和解调电流分别低至480uA和520uA，基准电压源温漂小于±10ppm/°C，DAC环路电流最大非线性误差小于±0.01%FS。上述芯片为工业现场传感器信号数据处理和通讯传输提供了高抗干扰解决方案，确保了工控通讯系统的可靠性，在芯片性能指标上达到了国际巨头同类产品的先进水平，可兼容替代亚德诺（ADI）等国际龙头的A5191、HT2015、AD5700、DS8500、AD421等系列芯片，成为国内率先设计出工控HART类芯片及4~20mA电流DAC芯片并进行商业化的企业之一。

在高精度ADC的数模混合SoC技术方面，2012年在国内针对智能传感器信号测量领域较早推出带24位高精度ADC的SoC芯片并成功实现商业化，其中ADC的等效输入噪声低至22nVrms，精度有效位数高达21位，在同类SoC芯片中达到国内领先、国际先进的水平。公司通过不断的技术创新，在高精度ADC的数模混合SoC技术基础上，针对特定应用场景自主定制创新性软件算法模型，将该项技术广泛应用于红外测温、多功能数字万用表、中高端智慧健康衡器、可穿戴便携式家庭医疗设备等高精度测量场合，进一步提升了各类细分终端应用产品的品质以及技术水平。

（二）团队及人才优势

公司始终秉承“以人为本，开拓创新，创造财富，共享成果，反哺社会”的价值理念，坚持积极进取的人才培养方式和人才选拔任用程序。经过 18 年的自主研发及技术积累，公司研发人员占比高达 71.68%，拥有专业的 IC 设计研发能力及国际化视野，在创新产品的研发上形成了显著优势。在人才选拔上，公司采用面向社会公开招聘、本企业内部竞聘上岗及民主推荐的组织选拔等多方式、多渠道模式培养和选拔人才。在薪酬福利方面，公司不断优化人员结构，设计多元化的薪酬福利方案，使得关键员工在全方面技能培养、薪酬调整、职务晋升、后备干部选拔等方面均得到充分保证。报告期内，为了配合公司新领域的拓展，公司正在加强引进高端研发人才。

（三）产品差异化竞争优势

鉴于国内 IC 企业在技术实力、资金实力等方面与国际巨头相比都存在较大的差距，为了实现弯道超车，公司集中力量于某一领域的独特优势，在细分领域发展壮大，形成细分市场领域的差异化优势。公司始终专注于工控类芯片及医疗健康类芯片的研发与销售，依靠自身专业的人才团队，及对未来市场发展的判断，在细分领域深耕十多年，根据市场和应用的需求和反馈，不断进行产品的迭代及技术的升级完善，通过生产不同类型的芯片产品来满足下游应用领域客户的各类需求，在红外测温、电子秤、智能秤、工业控制类（HART）、数字万用表等多个细分领域均做到了领先优势。公司在保证产品质量与性能指标的同时，产品价格较国际巨头也保持了一定的优势，具有较高的性价比，形成了比较明显的产品差异化优势。

（四）整体技术解决方案及本土化服务优势

相较于同行业，公司建立了完善的应用方案开发及服务团队，能为客户提供全面的应用方案。基于在行业内十几年的技术积累，公司能够根据不同领域客户的实际需求，建立了完善的客户服务团队，深度参与应用方案的开发，为客户设计定制在技术、工艺、应用等方面均符合客户要求整体解决方案。公司凭借高品质的芯片产品及完善的定制化整体应用方案，赢得了市场及客户的认可，针对客户的个性化需求及反馈能够做到快速响应，用可靠的产品质量和完善的配套服务，加强了客户对公司的粘性。

七、研发支出变化及研发进展

2023年1-6月，公司研发支出情况如下：

单位：万元

时间及事项	本报告期	上年同期	变化幅度
费用化研发投入	3,286.48	1,644.51	99.85%
资本化研发投入	-	-	不适用
研发投入合计	3,286.48	1,644.51	99.85%
研发投入总额占营业收入比例（%）	50.61	24.06	增加 26.55 个百分点
研发投入资本化的比重（%）	-	-	不适用

2023年1-6月，公司研发费用3,286.48万元，同比增长99.85%；研发投入占营业收入的比例为50.61%。主要系：①公司持续重视研发投入，积极扩充研发团队，至2023年6月末公司研发人员124人，同比增长65.33%；②公司推进研发进度，加快产品布局，研发用材料费用同比增长360.35%。

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致（如有）

不适用。

九、募集资金的使用情况是否合规

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州晶华微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1203号），公司首次向社会公开发行人民币普通股1,664万股，每股发行价格为人民币62.98元，募集资金总额为1,047,987,200.00元；减除发行费用人民币127,450,183.35元后，募集资金净额为920,537,016.65元。上述募集资金已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年7月26日出具了验资报告（天健验〔2022〕385号）。为规范公司募集资金管理和使用，上述募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了募集资金三方监管协议。

截至2023年6月30日，公司募集资金累计使用及结余情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金总额	104,798.72

减：相关发行费用	12,745.02
募集资金净额	92,053.70
减：募集资金累计使用额	7,670.99
其中：项目投入（补充流动资金）	2,000.00
超募资金永久补充流动资金	5,100.00
项目投入	570.99
加：募集资金利息收入扣除手续费、汇兑损失净额	670.25
截至 2023 年 6 月 30 日应结余募集资金余额	85,052.96
截至 2023 年 6 月 30 日实际结余募集资金余额	85,052.96
差异	-

注：利息收入净额包含购买理财产品产生的投资收益金额。

公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金管理和使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的持股均不存在质押、冻结及减持的情形。

十一、上市公司是否存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告或应当发表意见的其他事项

2023 年 7 月 31 日，公司收到浙江证监局出具的《关于对杭州晶华微电子股份有限公司进行现场检查的通知》。2023 年 8 月 6 日至 2023 年 8 月 11 日，浙江证监局对公司开展现场检查工作。公司在现场检查期间积极配合浙江证监局的检查工作，对浙江证监局现场检查初步提出的问题高度重视，并积极予以整改和完

善。截至本持续督导跟踪报告出具日，公司尚未收到浙江证监局出具的关于本次现场检查的结果通知。

（以下无正文）

(本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于杭州晶华微电子股份有限公司
2023 年度持续督导半年度跟踪报告》之签字盖章页)

保荐代表人：



薛 阳



余 冬



海通证券股份有限公司

2023年 9 月 15 日